(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月18日(18.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/191894 A1

(51) 国際特許分類:
B29C 43/18 (2006.01) *H01L 21/56* (2006.01)
B29C 43/58 (2006.01) *H01L 23/28* (2006.01)
H01L 21/50 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/035381

(22) 国際出願日： 2024年10月3日(03.10.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-039805 2024年3月14日(14.03.2024) JP

(71) 出願人：ＴＯＷＡ株式会社 (**TOWA CORPORATION**) [JP/JP]；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 (JP).

(72) 発明者：須江 絢(**SUE, Aya**)；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 ＴＯＷＡ株式会社内 (JP). 北 一平(**KITA, Ippei**)；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 ＴＯＷＡ株式会社内 (JP). 柳 裕(**YANAGI, Yu**)；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 ＴＯＷＡ株式会社内 (JP).

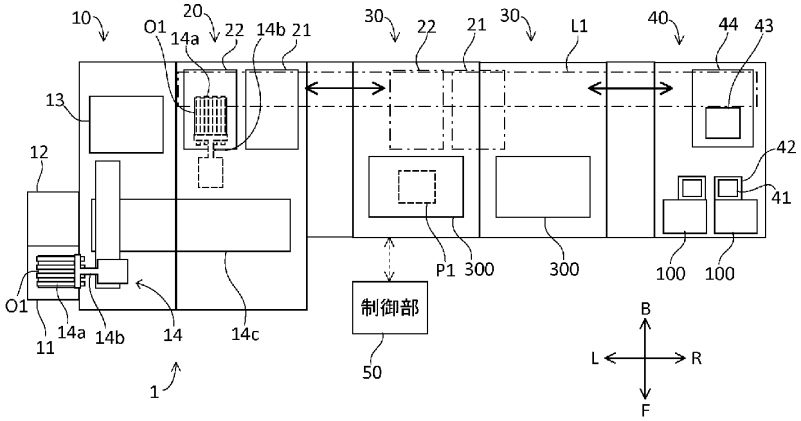
(74) 代理人：藤原 賢司，外 (**FUJIWARA, Satoshi** et al.)；〒5300047 大阪府大阪市北区西天満５－１－１５西天満パークビル２号館４階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能)：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

(54) **Title:** RESIN MOLDING DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING RESIN MOLDED ARTICLE

(54) 発明の名称： 樹脂成形装置、及び、樹脂成形品の製造方法

FIG.1



50 Control unit

(57) **Abstract:** This resin molding device carries out compression molding. The resin molding device comprises a mold, a mold clamping mechanism, and a sensor. The mold includes an upper mold and a lower mold facing the upper mold. The mold clamping mechanism carries out mold clamping of the mold. The mold clamping is carried out in a state in which a molding object is disposed on the lower surface of the upper mold and a resin is disposed on the upper surface of the lower mold. The molding object includes a substrate and a plurality of electronic components arranged on the substrate. In a state in which the molding object is disposed on the lower surface of the upper mold, the plurality of electronic components are positioned below the substrate. In the state in which the molding object is disposed on the lower surface of the upper mold, the sensor detects that at least some of the plurality of electronic components fall downward from the substrate.

WO 2025/191894 A1

［続葉有］

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：樹脂成形装置は、圧縮成形を行なう。この樹脂成形装置は、成形型と、型締め機構と、センサとを備える。成形型は、上型と、上型に対向する下型とを含む。型締め機構は、成形型の型締めを行なう。型締めは、上型の下面に成形対象物が配置され、かつ、下型の上面に樹脂が配置された状態で行なわれる。成形対象物は、基板と、基板上に配置された複数の電子部品とを含む。上型の下面に成形対象物が配置された状態で、複数の電子部品の各々は、基板の下方に位置する。センサは、上型の下面に成形対象物が配置された状態で、複数の電子部品の少なくとも一部が基板から下方へ落下していることを検出する。